



平成 24 年 2 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成 23 年 10 月 6 日
上場取引所 福

上場会社名 ジェイエムテクノロジー株式会社
コード番号 2423 URL <http://www.jmtech.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 植木 一夫
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部長 (氏名) 柴田 義治
四半期報告書提出予定日 平成 23 年 10 月 12 日
配当支払開始予定日 —
四半期決算補足説明資料作成の有無: 有・無
四半期決算説明会開催の有無: 有・無

TEL 092 - 272 - 4151

(百万円未満切捨て)

1. 平成 24 年 2 月期第 2 四半期の連結業績 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 23 年 8 月 31 日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24 年 2 月期第 2 四半期	1,614	1.7	41	57.2	41	19.2	18	2.0
23 年 2 月期第 2 四半期	1,588	3.5	26	37.8	34	80.3	17	1288.4

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24 年 2 月期第 2 四半期	1,241.17	—
23 年 2 月期第 2 四半期	1,217.20	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24 年 2 月期第 2 四半期	1,152	865	75.1	59,015.87
23 年 2 月期	1,155	861	74.6	58,752.34

(参考) 自己資本 24 年 2 月期第 2 四半期 865 百万円 23 年 2 月期 851 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23 年 2 月期	—	0.00	—	1,000.00	1,000.00
24 年 2 月期	—	0.00			
24 年 2 月期 (予想)			—	1,000.00	1,000.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無: 有・無

3. 平成 24 年 2 月期の連結業績予想 (平成 23 年 3 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	3,200	4.0	76	22.6	75	8.4	31	14.7	2,135.61

(注) 当四半期における業績予想の修正有無: 有・無

4. その他

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 有・☒無
 新規 一社(社名)、除外 一社(社名)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : ☒有・無
 (注) 詳細は添付資料P. 2「2. その他の情報」をご覧ください。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 : ☒有・無
 ② ①以外の変更 : ☒有・無
 (注) 詳細は添付資料P. 2「2. その他の情報」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年2月期2Q	17,718株	23年2月期	17,718株
② 期末自己株式数	24年2月期2Q	3,055株	23年2月期	3,055株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年2月期2Q	14,663株	23年2月期2Q	14,663株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

※ この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は添付資料のP. 2「2. その他の情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	1
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	1
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	1
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. その他の情報	2
(1) 重要な子会社の異動の概要	2
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	2
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書	6
(第2四半期連結累計期間)	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) セグメント情報	8
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	10
研究開発費の実績値	10

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国市場の需要拡大等により企業収益に一部回復の兆しが見られるものの、企業の設備投資の縮小や、雇用環境に対する先行き不安を背景とした個人消費の低迷等により、引き続き厳しい状況で推移いたしました。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、被災地に未曾有の被害をもたらすとともに、生産、原料調達、物流、電力供給等に多大な影響を及ぼし、今後のわが国経済の先行きは予断を許さない状況にあります。

情報システム業界におきましては、顧客の情報化投資の縮小、延期等、設備投資を抑制する動きが続いており、受注環境は依然として厳しい状況にあります。

半導体業界におきましては、パソコンやデジタル家電の需要回復を背景に、半導体メーカーの生産に回復の兆しが見られるものの、設備投資が本格的に回復するまでには至っておりません。

このような状況のもと、当社グループは積極的な受注活動を行うとともに各種経費の見直し・削減に努め、厳しい状況を乗り越えるべく対応を行いました。

以上の結果、売上高は1,614,458千円（前年同期比1.7%増）、営業利益は41,880千円（前年同期比57.2%増）、経常利益は41,553千円（前年同期比19.2%増）、四半期純利益は18,199千円（前年同期比2.0%増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① IT事業

IT事業につきましては、ITインフラの構築・設計支援、業務系を中心としたWeb系システムの開発等の分野を中心に、既存の顧客との取引拡大に注力いたしました結果、売上高は921,724千円、営業利益は44,510千円となりました。

② 半導体事業

半導体事業につきましては、引き続きアプライドマテリアルズジャパン株式会社からの受注の確保を図るとともに、国内半導体メーカーからの直受け業務の拡大や部品販売等の強化に注力いたしました結果、売上高は692,734千円、営業利益は95,907千円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,152,552千円、負債は287,202千円、純資産は865,349千円となりました。

(流動資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,018,244千円であり、その主な内訳は、現金及び預金567,654千円、受取手形及び売掛金344,466千円、仕掛品68,129千円であります。

(固定資産)

当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、134,308千円であり、その主な内訳は、事務所の内装等の建物附属設備9,401千円、パソコンをはじめとした工具器具備品10,175千円、連結子会社の吸収合併に伴い発生したのれん47,601千円、事業所等の差入保証金40,377千円であります。

(流動負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、287,202千円であり、その主な内訳は、買掛金12,206千円、未払金139,716千円、未払費用47,412千円、未払法人税等37,462千円、未払消費税等14,198千円、賞与引当金22,144千円であります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、配当金の支払14,663千円、四半期純利益18,199千円の計上により、865,349千円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から15,283千円増加し、567,654千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、得られた資金は47,985千円（前年同期は15,554千円の使用）となりました。これは税金等調整前四半期純利益41,828千円に対し、減価償却費6,650千円、のれん償却費4,407千円、売上債権の減少額36,740千円、未払費用の減少額49,469千円、賞与引当金の増加額22,144千円、法人税等の支払額17,667千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は19,078千円（前年同期は17,520千円）となりました。これは有形固定資産の取得による支出3,698千円、無形固定資産の取得による支出5,000千円、投資有価証券の取得による支出10,000千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、使用した資金は14,454千円（前年同期は7,205千円）となりました。これは、配当金の支払額14,454千円によるものであります。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年2月期の見通しにつきましては、平成23年4月15日に発表いたしました通期業績予想の数値から変更はございません。

2. その他の情報

（1）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

②繰延税金資産の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(会計処理基準に関する事項の変更)

1 資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

2 企業結合に関する会計基準等の適用

第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。

(表示方法等の変更)

四半期連結損益計算書関係

1 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用により、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

2 半導体製造装置関連部品販売に係る売上高及び売上原価については、従来は顧客の依頼に基づき補修部品等を販売する取次業務の占める割合が多かったことから、売上高から売上原価を差引いた純額で表示しておりましたが、近年、顧客数の増加により当社グループにおける半導体製造装置関連部品販売事業の重要性が高まるとともに、在庫保有を前提とした部品販売額の金額が増加したことから、第1四半期連結会計期間より売上高と売上原価をそれぞれ計上する総額表示に変更しております。これにより、従来の表示と比べ、当第2四半期連結累計期間の売上高及び売上原価がそれぞれ39,564千円増加しております。

3 前第2四半期連結累計期間において、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第2四半期連結累計期間の営業外費用の「雑損失」に含まれる「為替差損」は80千円であります。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成23年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成23年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	567,654	552,371
受取手形及び売掛金	344,466	380,842
商品及び製品	2,788	7,462
仕掛品	68,129	59,658
原材料及び貯蔵品	229	736
その他	35,855	27,687
貸倒引当金	△879	△1,094
流動資産合計	1,018,244	1,027,664
固定資産		
有形固定資産	※1 22,762	※1 23,388
無形固定資産		
のれん	47,601	52,008
その他	9,782	7,044
無形固定資産合計	57,383	59,053
投資その他の資産		
その他	58,377	49,567
貸倒引当金	△4,216	△4,216
投資その他の資産合計	54,161	45,351
固定資産合計	134,308	127,792
資産合計	1,152,552	1,155,457
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,206	6,588
未払金	139,716	142,517
未払費用	47,412	96,760
賞与引当金	22,144	—
未払法人税等	37,462	21,345
その他	28,261	26,759
流動負債合計	287,202	293,971
負債合計	287,202	293,971

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成23年8月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成23年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	326,200	326,200
資本剰余金	348,080	348,080
利益剰余金	263,922	260,386
自己株式	△73,072	△73,072
株主資本合計	865,130	861,593
評価・換算差額等		
為替換算調整勘定	219	△108
評価・換算差額等合計	219	△108
純資産合計	865,349	861,485
負債純資産合計	1,152,552	1,155,457

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日)
売上高	1,588,064	1,614,458
売上原価	1,295,615	1,319,418
売上総利益	292,448	295,040
販売費及び一般管理費	※ 265,812	※ 253,159
営業利益	26,635	41,880
営業外収益		
受取利息	276	70
助成金収入	—	700
補助金収入	9,684	—
雑収入	54	206
営業外収益合計	10,015	977
営業外費用		
為替差損	—	676
支払手数料	425	312
賃貸借契約解約損	1,077	235
雑損失	290	80
営業外費用合計	1,794	1,304
経常利益	34,857	41,553
特別利益		
固定資産売却益	85	60
貸倒引当金戻入額	186	214
特別利益合計	272	274
特別損失		
固定資産除却損	998	—
特別損失合計	998	—
税金等調整前四半期純利益	34,131	41,828
法人税、住民税及び事業税	21,176	34,033
法人税等調整額	△4,892	△10,404
法人税等合計	16,283	23,629
少数株主損益調整前四半期純利益	—	18,199
四半期純利益	17,847	18,199

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	34,131	41,828
減価償却費	5,914	6,650
のれん償却額	4,407	4,407
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△186	△214
賞与引当金の増減額(△は減少)	21,051	22,144
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△10,000	—
有形固定資産除却損	407	—
有形固定資産売却損益(△は益)	△85	△60
売上債権の増減額(△は増加)	22,003	36,740
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,301	△3,274
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,975	5,618
未払金の増減額(△は減少)	△45,087	△769
未払費用の増減額(△は減少)	△47,782	△49,469
未払消費税等の増減額(△は減少)	9,159	1,201
その他	4,365	780
小計	△3,377	65,582
利息及び配当金の受取額	276	70
法人税等の還付額	4,627	—
法人税等の支払額	△17,081	△17,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,554	47,985
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△9,108	△3,698
有形固定資産の売却による収入	238	100
無形固定資産の取得による支出	△3,657	△5,000
投資有価証券の取得による支出	△5,000	△10,000
差入保証金の差入による支出	△3,119	△1,417
差入保証金の回収による収入	2,796	847
貸付金の回収による収入	329	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,520	△19,078
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△7,205	△14,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,205	△14,454
現金及び現金同等物に係る換算差額	△369	830
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△40,651	15,283
現金及び現金同等物の期首残高	574,837	552,371
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 534,185	※ 567,654

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自 平成22年3月1日 至 平成22年8月31日）

	I T 事業 (千円)	半導体事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全 社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	1,034,942	553,121	1,588,064	—	1,588,064
(2) セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—
計	1,034,942	553,121	1,588,064	—	1,588,064
営業利益	70,660	74,833	145,494	(118,858)	26,635

(注) 1. 事業は取扱いサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業区分に属する主要な製品及びサービスは次のとおりであります。

事業区分	主要製品・サービス
I T 事業	I T ソフト設計・開発・販売、I T インフラ設計・構築
半導体事業	半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス、部品販売

3. 会計方針の変更による影響額

(受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更)

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェアにかかる契約から、当第2四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウェア制作については検収基準を適用しております。

これにより、当第2四半期連結会計期間の売上高が I T 事業について2,939千円増加し、営業利益は903千円増加しております。半導体事業については影響ありません。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自平成22年3月1日 至平成22年8月31日）

第1四半期連結会計期間において、JM Singapore IT Solutions Pte. Ltd. を新規設立し、連結の範囲に含めておりますが、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメントの情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間（自平成22年3月1日 至平成22年8月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、取り扱う製品・サービス別に「IT事業」、「半導体事業」の二種類の事業を行っており、各事業ごとに各々包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業の種類を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「IT事業」、「半導体事業」の2つを報告セグメントとしております。

「IT事業」は、ITインフラの構築・設計支援、業務系を中心としたWeb系システムの開発、基盤系システムの開発、FA・生産管理システムの開発、ソフトウェアに関する要員派遣、一般人材派遣等を行っております。「半導体事業」は、国内半導体メーカーの工場における半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス等のカスタマーサービス業務、半導体通信制御システムの開発、半導体製造装置に関する部品の修理・販売を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間（自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日）

	報告セグメント			その他 (注)	四半期連結損益 計算書計上額
	IT事業	半導体事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	921,724	692,734	1,614,458	—	1,614,458
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	921,724	692,734	1,614,458	—	1,614,458
セグメント利益	44,510	95,907	140,417	(98,537)	41,880

(注) 「その他」の区分の98,537千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、その主な内容は、当社の管理部門に係る費用であります。

3. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメントの利益の合計額と四半期損益計算書計上額との差額は、「その他」の区分の利益であります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報】

該当事項はありません。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

研究開発費の実績値

当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は9,478千円であります。これは、I T事業における販売目的の製品開発によるものであります。